

JORNADA GRATUITA

SOLUCIONES TÉRMICAS PARA POLÍMEROS Y COMPOSITES

21 MAYO 2019
EN TECNALIA

Agenda

- 09:00 Presentación
TECNALIA, AEMAC, FIDAMC Y NETZSCH
- 09:30 Dynamic Mechanical Analysis (DMA) on Thermosets and Composites
Stephan Knappe, NETZSCH A&T
- 10:15 Reología aplicada a la fabricación de materiales compuestos
Vanessa García Martínez, FIDAMC
- 10:45 Café
- 11:15 Estudio cinético para RTM6 con DSC y Kinetics Software
Gonzalo Oteo, NETZSCH A&T
- 11:45 Caracterización y modelización de materiales para el desarrollo de procesos de composite 4.0.
Desde la caracterización en el laboratorio al gemelo digital.
Isabel Harismendy, TECNALIA
- 12:15 Visita instalaciones TECNALIA
- 13:30 Comida
- 14:45 Measurements of Thermophysical Properties on Composite Materials by Using Laser Flash Method
Andre Lindemann, NETZSCH A&T
- 15:15 Los Objetivos de la Asociación Española de Materiales Compuestos
Helena Abril, AEMAC
- 15:30 Monitorización de Curado de Resinas Termoestables DEA (Análisis Dieléctrico)
Demostración práctica del DEA 288 Ionic
Ramón Araúz, NETZSCH A&T
- 16:15 Preguntas
- 16:30 Despedida

ORGANIZA

NETZSCH

NETZSCH-Gerätebau GmbH
Spain Branch Office
Frutuós Gelabert 2-4, 4º 1ª
08970 Sant Joan Despí (Barcelona)
Spain
Tel.: +34 609 115 217
gonzalo.oteo@netzsch.com
www.netzsch.com

COLABORA

AEMAC
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE MATERIALES COMPUESTOS

FIDAMC

tecnalia Inspiring Business

LUGAR

TECNALIA
Parque Tecnológico de San Sebastián
Mikeletegi Pasealekua, 2
E-20009 Donostia-San Sebastián
Tel.: +34 902 760 000
www.tecnalia.com